

# 参加募集 第45回エンジニアリングセラミックスセミナー 「セラミックスの新しい成形・焼結技術」

## ーセラミックスの成形・焼結技術の基礎及び最近の動向ー

多くのセラミックスは、原料粉体を混合後、成形・焼結し、必要に応じて機械加工等を施すことを基本プロセスとして製造されています。セラミックスの特性は微構造により大きく変化するため、セラミックスの製造過程において「成形」及び「焼結」はセラミックスの特性を決める重要な過程となります。そのため、セラミックスの高性能化を目指した種々の成形・焼結手法が開発され、実施されています。本年度のセミナーでは、大学及び企業からこれらの分野で著名な講師の方々を招き、セラミックスの成形・焼結の基礎、新しい成形・焼結プロセス技術およびその応用例を紹介していただくと共に、これからの新たな展開についても講演していただくことになっております。普段の学会や講演会では得ることのできないヒントやアイデアを発見できる良い機会だと思いますので、セラミックス研究分野の方のみならず、多方面から多くの皆様のご参加をお待ちしております。

主 催：日本セラミックス協会 エンジニアリングセラミックス部会

協 賛：応用物理学会、耐火物技術協会、電気化学会、日本化学会、日本金属学会、日本物理学会、粉体粉末冶金協会（予定）

開催日時：2013年7月25日（木）13:30～18:10

場 所：東京工業大学田町キャンパス キャンパス・イノベーションセンター 国際会議室

URL：<http://www.cictokyo.jp/index.html> TEL：03-5440-9020（受付）

東京都港区芝浦3-3-6

JR 田町駅芝浦口から徒歩1分、都営地下鉄浅草線・三田線 三田駅から徒歩5分

定 員：100名（定員になり次第、締め切ります）

参加費：会員13,000円（協賛学協会を含む）、学生会員6,000円、非会員15,000円  
（申込時入会は会員扱）（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（[http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index\\_j.html](http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html)）の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー前日までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合先：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17

公益社団法人日本セラミックス協会 エンジニアリングセラミックス部会

TEL：03-3362-5231 FAX：03-3362-5714

振込先：三菱東京UFJ銀行 千里中央支店（普）0073211

（社）日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義  
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます。

### プログラム

13:40~14:20 「高強度・高信頼の獲得に向けた成形の戦略」

（長岡技術科学大学 名誉教授、植松セラミックス技術相談所）植松 敬三

14:20~15:00 「ゲルキャストによる成形の基本と応用」

（名古屋工業大学）藤 正督

15:10~15:50 「光造形法を用いた機能性セラミックスの精密成型」

（大阪大学）桐原 聡秀

15:50~16:30 「セラミックスの焼結力学」

（東京工業大学）若井 史博

16:40~17:20 「ミリ波帯電磁波プロセッシングによる材料創成と加工処理」

（有）MSP 巻野 勇喜雄

17:20~18:00 「放電プラズマ焼結（SPS/ECAS）法の最近の技術動向

ー迅速・反応焼結による大形セラミックス焼結と製品開発ー

（株）エヌジェーエス 鴫田 正雄